

电子行业周报 (12.25-12.31)

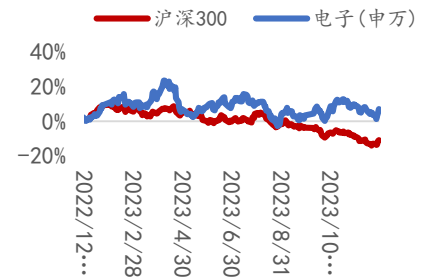
小米 SU7 发布，智能汽车再下一城

强于大市(维持评级)

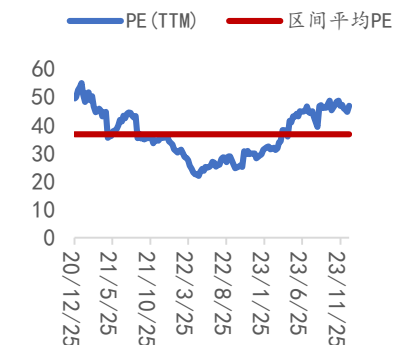
投资要点:

- **历经千日锤炼，技术指标行业领先。**2023年12月28日，小米集团首次召开新能源汽车技术发布会，这意味着小米自2021年3月对外宣布造车起，历时近三年，其首款纯电智能汽车SU7即将面世。小米汽车采取自研和与供应链合作两种模式，车辆多项性能参数达到国际领先水平。如：1) 零百加速2.78s，超过保时捷Tycan Turbo的2.93s；2) 拥有全球量产车型中最低风阻系数Cd 0.195；3) 自研超级一体化压铸技术，最大锁模力达9100吨，超过特斯拉目前美国工厂的9000吨。4) 自研V8S电机，转速高达27200rpm，刷新全球电机转速最高记录；5) 与宁德时代共同研发CTB电池一体化技术，800碳化硅高压平台，最高电压达871V，CLTC 续航800km，充电5分钟实现200km续航，且已通过全球最严苛的热失效安全标准，采取行业首创的电芯倒置技术以确保车辆安全等。雷军表示，小米汽车将通过15-20年的努力，成为全球前五的汽车厂。
- **全栈自研智驾大模型与智舱OS，C级科技生态桥跑呼之欲出。**小米汽车虽在智能驾驶技术方面起步相对较晚，但相关投资已经从33亿元追加至47亿元，目前相关AI工程师规模已达3000人。智能驾驶域控基于英伟达双Orin-X芯片，小米自研变焦BEV、超分辨率占用网络技术以及道路大模型等自动驾驶技术，道路大模型可实时生成道路拓扑，效果媲美高精地图，从而实现路口识别，障碍物自动绕行等功能，并计划2024年底开通100个城市的城区领航NOA。在智能座舱方面，基于小米自研澎湃OS，搭载高通8295座舱SoC，兼容小米平板生态无缝上车，手机应用可秒变车机原生应用，届时将有上千种APP与之适配。另外，米家设备无感上车，中控屏支持硬件拓展，CarIoT全面向第三方开放，如支持Carplay，兼容Airplay，支持iPad上车等，让苹果手机用户也拥有同样较好的小米汽车驾驶体验。在SU7上市后，小米在现有的品牌、销售渠道、庞大用户基础等竞争优势之下，有望进一步丰富小米生态系统，真正实现人、车、家等生态协同。
- **销量预期成舆论焦点，定价或是其中关键。**造车新势力的销量表现一直备受产业链、媒体以及消费者等关注，作为初入智能电动汽车圈的新势力，且在消费电子等领域已经取得斐然成绩且拥有一定行业定位的小米来说，SU7的销量预期常常也是舆论焦点。据中汽协数据，预计2023年国内乘用车总销量将达2600万辆，其中新能源汽车销量预计达940万辆，同比分别增长10.3%和36.5%。据杰兰路针对汽车售价与销量数据分析，2023H1，新能源汽车售价在10-20万和20-30万两个区间，对应销量分别为132.3万辆和67.62万辆，占比分别为45%和23%，合计占比68%。可见，新能源汽车定价和销量存在紧密联系，在售价10-30万区间内，销量占比过半，比重最大。在此次发布会上，雷军明确表示，基于当前SU7软硬件配置，售价不会低至14.9万元。故在此预测，结合车辆定位和市场销量空间等综合分析，SU7将按照不同车型高中低配，整体终端定价将有望落在15-30万元区间，目前看来具有较大的可能性。
- **投资建议：**汽车智能化产业链相关标的，建议关注：**德赛西威、经纬恒润、拓普集团、保隆科技、华阳集团**等。半导体方向，建议关注上游设备、材料、零部件国产替代机会，如**昌红科技、新莱应材、正帆科技、汉钟精机、腾景科技、英杰电气、苏大维格**等，以及IC封装领域重点公司，如**长电科技、通富微电、华天科技、晶方科技**等。消费电子方向，建议关注MR产业链相关机会，如**立讯精密、歌尔股份、长盈精密、华兴源创、易天股份、领益智造、三利谱、水晶光电、京东方A、清越科技、兆威机电、精测电子、中石科技**等。
- **风险提示：**新车量产及交付时间延期风险，新能源车销量不及预期，行业竞争加剧，地缘政治风险，电子行业景气复苏不及预期。

一年内行业相对大盘走势



电子行业估值 (PE)



团队成员

分析师 杨舒

执业证书编号: S0210522110003

邮箱: yz3979@hfzq.com.cn

相关报告

- 《MR 核心部件，硅基 OLED 待时而飞》—— 2024.01.01
- 《MR 蓄势待发，开辟空间计算新纪元》—— 2023.12.17
- 《AMD 加码，AI PC 加速落地》—— 2023.12.11

正文目录

一、	本周市场表现.....	3
1.1	电子板块本周表现.....	3
1.2	SW 电子个股本周表现.....	3
1.3	电子板块估值分析.....	4
二、	行业动态跟踪.....	6
2.1	半导体板块.....	6
2.2	消费电子板块.....	8
2.3	汽车电子板块.....	9
2.4	AI 板块.....	11
2.5	面板板块.....	12
三、	公司动态跟踪.....	13
四、	风险提示.....	14

图表目录

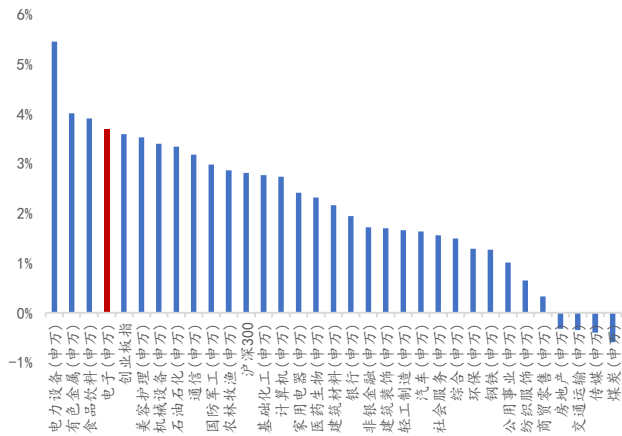
图表 1:	SW 各行业板块本周市场表现.....	3
图表 2:	电子板块成交额及日涨跌幅.....	3
图表 3:	电子细分领域本周涨跌幅 (%).....	3
图表 4:	SW 电子本周涨幅前十个股 (%).....	4
图表 5:	SW 电子本周跌幅前十个股 (%).....	4
图表 6:	SW 电子本周换手率前二十个股 (%).....	4
图表 7:	SW 电子行业指数 PE 走势 (TTM).....	5
图表 8:	SW 电子细分行业指数 PE 走势 (TTM).....	5
图表 9:	过去一周股东增减持更新.....	13
图表 10:	过去一周股权激励一览.....	14

一、 本周市场表现

1.1 电子板块本周表现

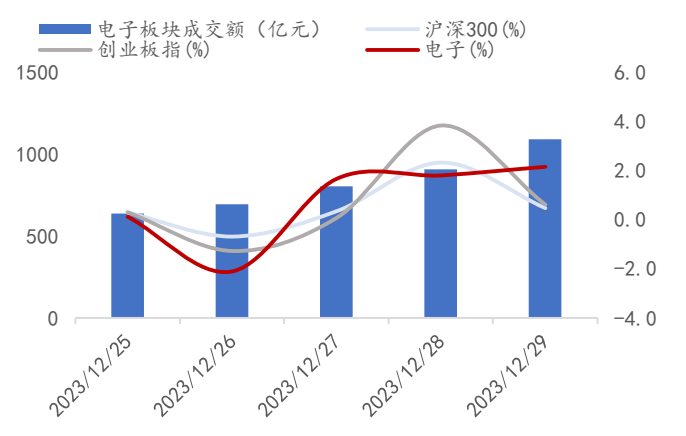
大盘表现上,本周(1225-1231)创业板指数上升3.59%,沪深300指数上升2.81%。本周电子行业指数上升3.68%。行业表现上,电子行业位列全行业的第4位。除此之外,本周电力设备、有色金属、食品饮料涨幅较大。

图表 1: SW 各行业板块本周市场表现



数据来源: Wind, 华福证券研究所

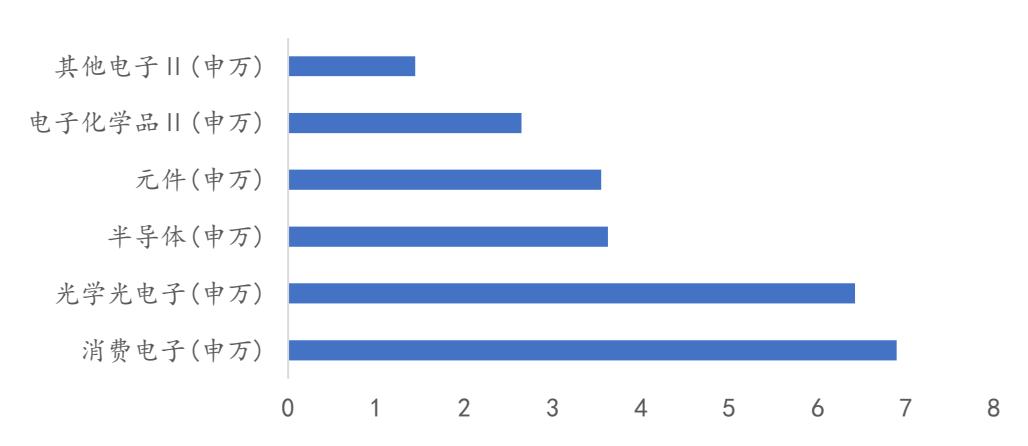
图表 2: 电子板块成交额及日涨跌幅



数据来源: Wind, 华福证券研究所

从电子细分行业指数看,本周全部电子细分赛道(半导体、消费电子、元件、光学光电子、电子化学品和其他电子)均有不同程度上升。具体来看,消费电子板块涨幅较大,周涨跌幅为6.89%,其他电子涨幅最小,周涨跌幅为1.44%。

图表 3: 电子细分领域本周涨跌幅 (%)

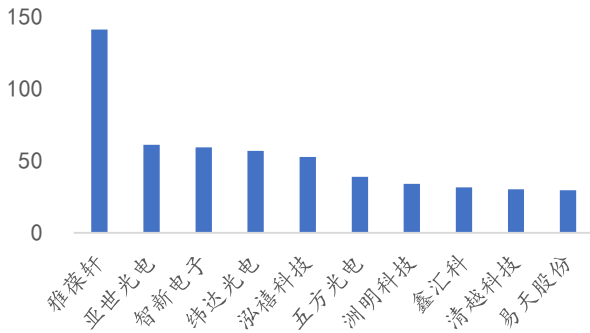


数据来源: Wind, 华福证券研究所

1.2 SW 电子个股本周表现

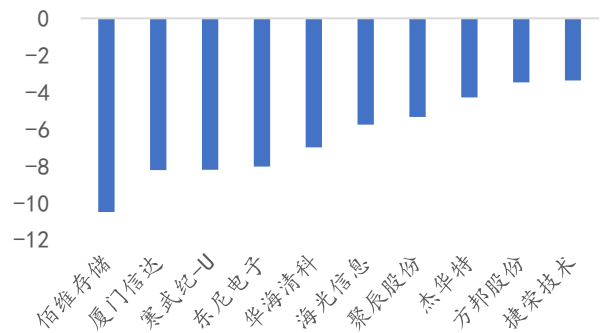
从个股维度来看,SW 电子板块中,雅葆轩(141.16%)、亚世光电(61.03%)等位列涨幅前列;佰维存储(-10.49%)、厦门信达(-8.21%)等位列跌幅前列。

图表 4: SW 电子本周涨幅前十个股 (%)



数据来源: Wind, 华福证券研究所

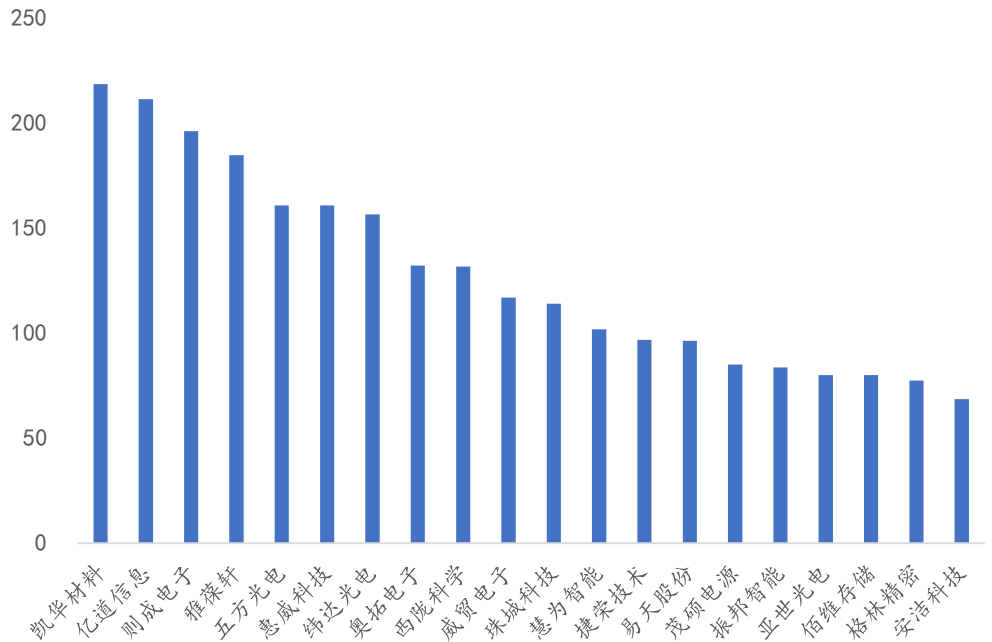
图表 5: SW 电子本周跌幅前十个股 (%)



数据来源: Wind, 华福证券研究所

从换手率来看,本周电子行业个股换手率最高的是凯华材料,换手率为 218.32%。其余换手率较高的还有亿道信息(211.10%)、则成电子(195.87%)和雅葆轩(184.49%)。

图表 6: SW 电子本周换手率前二十个股 (%)

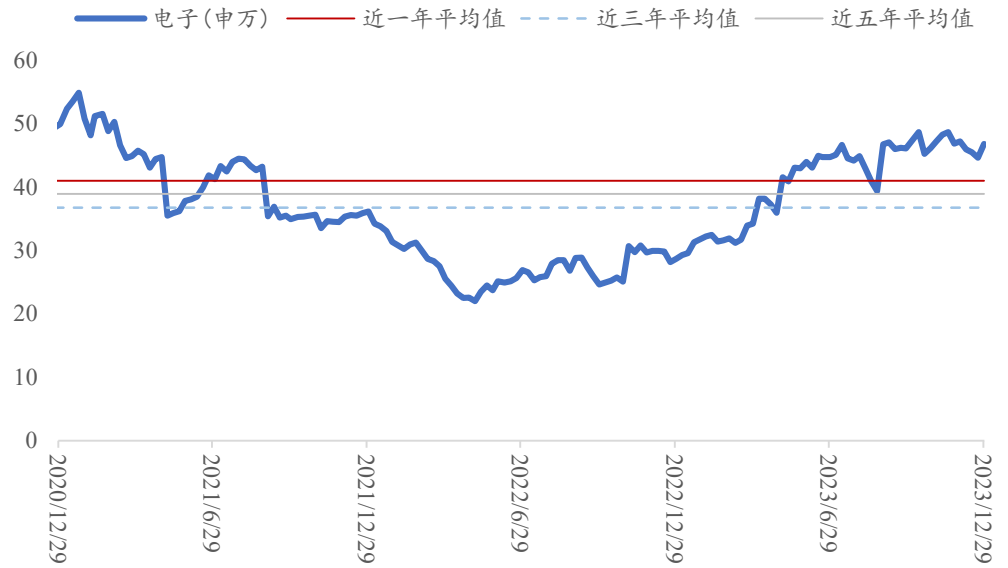


数据来源: Wind, 华福证券研究所

1.3 电子板块估值分析

从本周 PE 走势来看,整体电子行业估值高于近一年、三年、五年平均值水平。本周 PE (TTM) 为 46.81 倍,较上周略有上升,高于近一年区间 PE 平均值 41.04 倍、近三年区间 PE 平均值 36.78 倍和近五年区间 PE 平均值 38.94 倍。

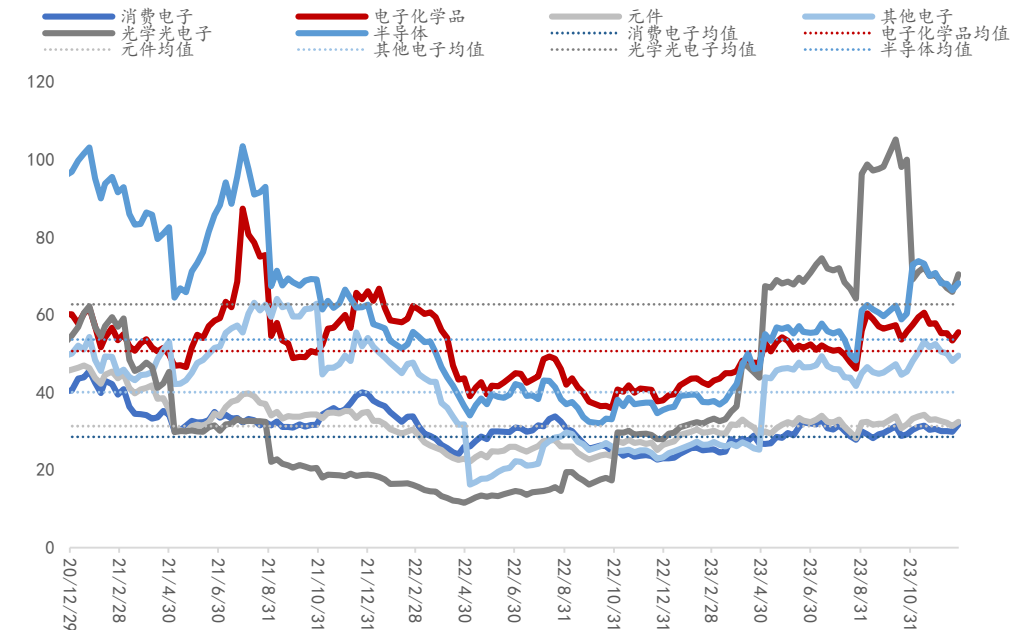
图表 7: SW 电子行业指数 PE 走势 (TTM)



数据来源: Wind, 华福证券研究所

细分领域上, 近一年消费电子、电子化学品、元件、其他电子、光学光电子和半导体板块 PE 均值分别为 31.70、55.43、32.37、49.37、70.38 和 68.05。电子细分板块本周 PE 均超过其近一年平均值, 其中, 半导体、其他电子、光学光电子本周 PE 远超过近一年平均值。本周电子细分板块估值均有一定程度上升。

图表 8: SW 电子细分行业指数 PE 走势 (TTM)



数据来源: Wind, 华福证券研究所

二、行业动态跟踪

2.1 半导体板块

1) 英特尔 CEO 称 18A 节点至少能与台积电的 N2 性能相媲美

随着半导体制造商巩固其 3 纳米制程并加紧向 2 纳米制程的竞争,台积电和英特尔最近就哪家公司将在未来几年内拥有更优越的节点展开了激烈的争论。台积电对自己目前的发展道路充满信心,但英特尔的目标是抢先进入 2 纳米工艺,重新确立在半导体行业的主导地位。

2) 2nm 每片晶圆成本 3 万美元,芯片制造成本增加 50%

International Business Strategies 分析师近日发布报告,称制造商过渡到 2nm 工艺后,相比 3nm 工艺,制造成本将增加 50%,导致每片 2nm 晶圆的成本为 3 万美元。IBS 预估,一家月产能 5 万片晶圆的 2nm 晶圆厂(WSPM)成本约为 280 亿美元,而建设相同产能的 3nm 晶圆厂,预估为 200 亿美元。

晶圆厂增加的成本,主要原因是 EUV 光刻工具数量的增加,大幅提高了每片晶圆和每块芯片的成本。根据台积电目前公布的路线图,计划在 2025-2026 年期间引入 N2 工艺。一片 300mm 的 2nm 晶圆,苹果需要支付大约 3 万美元的费用,而 N3 工艺晶圆,费用预估为 2 万美元。

3) 第三季度:半导体营收英伟达居首,晶圆代工台积电蝉联

市场调查机构 Counterpoint Research 近日发布数据,汇总报告了 2023 年第三季度全球半导体、晶圆代工份额情况。2023 年第三季度,全球晶圆代工行业,台积电得益于 N3 的产能提升和智能手机的补货需求,以 59% 的市场份额占据主导地位。排在第二位的是三星代工,占 13% 的份额。此后为联电、GlobalFoundries 和中芯国际。

在全球半导体收入方面,英伟达排名第一,由于科技巨头对人工智能服务器的强劲需求,预计英伟达将在未来几个季度继续在半导体收入表现中占据主导地位。而英特尔凭借着蓬勃发展的数据中心业务,位居第二,由于 PC 订单的增加,收入环比增长。

4) 机构:Q3 台积电、英伟达、高通和联发科引领晶圆代工、半导体营收及智能手机 AP 市场

市场调研机构 Counterpoint Research 发布多份行业统计报告,包括 2023 年第三季度全球半导体、晶圆代工和智能手机应用处理器(AP)市场营收和份额概况。其中,2023 年第三季度,全球晶圆代工行业的市场份额呈现出明显的等级。得益于 N3 的产能提升和智能手机的补货需求,台积电以 59% 的市场份额占据了主导地位。排在第二位的是三星 Foundry,占 13% 的份额。联电、格芯和中芯国际的市场份额相近,各占 6% 左右。

5) 中国台湾 11 月工业生产指数下滑,IC 设计与电脑增长

中国台湾经济部门公布 2023 年 11 月该地区工业生产指数，受全球终端需求疲软影响，工业生产指数 92.19，年减 2.48%；制造业生产指数 92.38，年减 2.18%，连续 18 个月同比负增长，创造史上最长衰退记录。

统计显示，11 月中国台湾电子零部件生产指数 93.68，同比减少 3.35%，该地区经济部门称，终端消费电子产品需求疲弱，拉长供应链库存调整周期。晶圆代工、IC 载板、IC 封装、光电材料及零部件等品类产量下滑，但是 IC 设计业因去年同期基数较低，同比实现增长。

中国台湾电脑电子产品及光学制品行业生产指数 126.69，创下新纪录，同比增长 14.01%，主要受惠于云数据中心、人工智能（AI）等应用需求旺盛，以及国际订单增长。光学领域的增长，得益于智能手机等产品对摄像头的需求增加。2023 年 1 至 11 月，中国台湾工业、制造业生产指数同比分别下降 13.22%、13.65%。

6) 消息称苹果最快 2025 年推出自研 Wi-Fi 芯片，对博通影响最大

苹果寻求对多种产品拥有尽可能多的芯片控制权，但这一目标并未像公司预期的那样实现。凭借其定制 SoC 芯片，行业观察人士认为，苹果在这一领域的实力无与伦比，但在开发定制 5G 基带和 Wi-Fi 芯片方面，该公司严重落后于供应商博通和高通。现在一份新报告指出，预计苹果将在 2025 年推出首款 Wi-Fi 芯片，博通将是首个遭受重大财务打击的公司。

据悉，苹果在开发定制 5G 基带和 Wi-Fi 芯片方面投入了大量资金，但具体金额尚未提及。不幸的是，这项投资似乎并没有取得成果，苹果遇到了“某些瓶颈”，有传言称该公司已经完全放弃开发 5G 基带芯片，该项目遭遇了性能、过热和其他问题，定制的 Wi-Fi 芯片很可能面临同样的情况。

7) 机构：DRAM、NAND 涨势确定，代表性产品两年半以来首次上涨

随着三星、美光等制造商减产效果显现，外加过剩库存消化，半导体存储芯片价格的涨势已经确定。其中代表性 DRAM 价格出现了两年半以来的首次上涨。

DRAM 产品中，11 月代表性产品 DDR4 8Gb 大宗交易价格为每片 1.65 美元左右，较 10 月上涨 11%，为 2021 年 6 月以来的首次上涨；NAND 产品中，2023 年 10-12 月代表性 TLC 产品 256Gb 价格为每片 1.85 美元左右，较上一季上涨 12%，为 9 个季度以来首次呈现上涨。

消息称因 PC、智能手机需求低迷，三星、美光、SK 海力士、铠侠等存储芯片厂商自 2022 年下半年相继进行减产，试图恢复价格。日本电子产品商社指出，“（存储芯片）库存过剩情况缓解，减产效应终于显现。”

8) 台积电 2nm 成本飙升将影响 AI 芯片市场

随着 2023 年即将结束，台积电将面临其领先半导体制造工艺的成本增加。目前台积电量产最先进的工艺是 3nm，一份报告显示，未来 3nm 和 2nm 节点的成本将大幅增加。分析师报告称，这些潜在的成本增加可能会影响苹果高端和低端科技产品的利润率。

3nm 是目前世界上最先进的生产工艺，台积电的大部分最新产品都供应给苹果。在 2022 年就有报道称，台积电的 3nm 晶圆成本约为每片 2 万美元，随后又有消息称每片晶圆成本可能会上升到 2.5 万美元或降至 2 万美元以下。在 2023 年，人工智能（AI）芯片崛起，搅动了半导体世界，晶圆成本将进一步影响产品成本计算以及昂贵芯片制造设施的投资预期。

9) 专家发布 2024 年半导体展望：四大应用正增长，总体涨幅可达 12%

研究机构 DIGITIMES Research 研究总监黄铭章发表 2024 年半导体产业展望。他认为人工智能（AI）将继续带动产业增长，2024 年下半年半导体从业者库存水平及出货将陆续恢复增长，全年全球半导体市场预计可增长 12%。

回顾 2023 年，整体半导体市场呈现大约 9% 的年减幅度，其中主要受存储芯片年减幅度达 35% 影响所致。少数持续增长的领域出现在 AI 相关的服务器 GPU、网络芯片、电动汽车相关功率半导体，例如碳化硅（SiC）、硅基 IGBT 等。全球 20 大半导体从业者中，预计仅有 5 家在 2023 年可实现营收正增长，包括英伟达、博通、英飞凌、意法半导体、恩智浦。

2.2 消费电子板块

1) 索尼扩大长崎工厂产能 押注中国小米、OPPO 等手机商业业务增长

索尼集团计划通过在中国智能手机制造商中发展业务来重振其图像传感器部门的盈利。

索尼集团总裁 Hiroki Totoki 12 月 22 日在日本长崎技术中心扩建工程竣工仪式上表示，图像传感器就像电子眼一样至关重要，我们将把它们提供给世界各地的客户。

索尼还计划在熊本县建造一座新的图像传感器工厂。索尼预计截至明年 3 月的财年，综合净利润将下降 13%，至 8800 亿日元（61 亿美元）。半导体部门的营业利润预计将下滑 8%，至 1.95 亿日元。

2) 一加 Ace 3 手机官宣：1.5K 8T LTPO 东方屏、Display P1 显示芯片

一加 Ace 3 智能手机目前已经官宣，将于 1 月 4 日 14:30 发布。这款手机升级为金属中框，延续上代摄像头模组设计语言，预计将搭载骁龙 8 Gen 2 处理器。

官方表示，一加 Ace 3 将全球首发 1.5K “东方屏”，这款屏幕将继承一加 12 的旗舰规格，采用京东方 X1 发光材料、8T LTPO 电路设计，峰值亮度达到 4500nit。这款手机还将同时搭载 OPPO 自研第一代显示芯片 Display P1，更流畅、更省电，带来屏幕体验代际式升级。

3) 苹果自研芯片拟采多元代工 市场猜测将与三星、英特尔合作

苹果硬件部门主管接受采访时，盛赞台积电对苹果自研芯片的贡献，但也透露，苹果对芯片代工来源多元化向来抱持开放态度。

市场关注，相关谈话是否意味苹果后续可能复制 iPhone 代工、关键零部件多元供应商模式，导入三星、英特尔等晶圆代工新伙伴，借此提高自身对供应链的议价能力。

媒体刊出访问苹果硬件科技高级副总裁斯鲁吉 (Johny Srouji) 和硬件工程高级副总裁特纳斯 (John Ternus) 的内容，谈到与苹果芯片业务相关的话题，特纳斯直言，苹果投入自研芯片，是公司过去 20 年来「最深刻的变化」。斯鲁吉表示：「由于我们不对外销售芯片，而是聚焦在产品上。这让我们有充裕可进行优化，而扩容式架构让我们可在不同产品间重复使用各部件。」

4) 中国信通院：前 11 月国内手机出货累计 2.61 亿部 同比增长 7.1%

中国信通院今日发布 2023 年 11 月国内手机市场运行分析报告显示，2023 年 1-11 月，国内市场手机总体出货量累计 2.61 亿部，同比增长 7.1%，其中 5G 手机出货量 2.15 亿部，同比增长 12.9%，占同期手机出货量的 82.5%。

从 11 月份来看，国内市场手机出货量 3121.1 万部，同比增长 34.3%，其中，5G 手机 2709.2 万部，同比增长 51.2%，占同期手机出货量的 86.8%。2023 年 1-11 月，国产品牌手机出货量累计 2.07 亿部，与上年同期基本持平，占同期手机出货量的 79.2%；上市新机型累计 380 款，同比增长 10.1%，占同期手机上市新机型数量的 91.6%。

在智能手机方面，2023 年 1-11 月国内智能手机出货量 2.50 亿部，同比增长 5.4%，占同期手机出货量的 95.7%。国内智能手机上市新机型累计 337 款，同比增长 6.0%，占同期上市新机型数量的 81.2%。

2.3 汽车电子板块

1) 蔚来汽车：明年新增 1000 座换电站和 2 万根充电桩

截至今年 11 月 18 日，蔚来今年已新增布局换电站 798 座，其中 646 座高速换电站，充电站 3,402 座、充电桩 19,824 根，三方桩 960,000+ 根，计划在 2025 年全面建成 9 纵 9 横 19 大城市群高速换电网络。除了国内市场，蔚来也在加快国际布局。

近日，蔚来与 CYVN Holdings 通过其附属公司 CYVN 订立股份认购协议。根据股份认购协议，CYVN 将投入现金总额 22 亿美元，以每股股份 7.5 美元的购买价认购 2.94 亿股公司新发行 A 类普通股。于 12 月投资交易交割后，蔚来和 CYVN 及其附属公司将继续共同合作，在国际市场上寻求战略和技术合作。

2) 蔚来发布行政旗舰轿车 ET9：预售价 80 万元，2025 年一季度交付

在 12 月 23 日于西安举行的 2023 NIO DAY 上，蔚来 ET9 正式亮相，定位为行政四座旗舰轿车。据介绍，蔚来 ET9 搭载蔚来自研智能驾驶芯片神玑 NX9031、全域 900V 高压架构、天行底盘系统 SkyRide 等全新技术。

此外，神玑 NX9031 采用 5nm 车规工艺制程，有超过 500 亿颗晶体管，支持 32 核 CPU。蔚来旨在用一颗自研芯片实现目前业界四颗旗舰智能驾驶芯片的性能，使得效率和成本更优。而 SkyRide 天行底盘系统则拥有线控转向、后轮转向和全主动悬架，其中后轮转向最大角度为 8.3°，最小转弯直径为 10.9 米。

3) 雷军官宣造车 1000 天，小米汽车技术将于 12 月 28 日全面展现

12月25日，小米联合创始人兼CEO雷军发文称，今天小米宣布正式造车的第1000天，今天也正式官宣，12月28日举行小米汽车技术发布会。雷军还强调，这次只发技术，不发产品。

雷军表示，在小米汽车团队刚组建时，就一起开了三天三夜的会，在会上达成全员共识：造车，百年赛道无捷径。坚持正向开发，从底层核心技术开始，十倍投入，造一辆好车！这些技术，12月28日的小米汽车技术发布会上，将正式向大家全面展现。

雷军称，智能电动汽车的发展趋势，就是汽车工业与消费电子工业、智能生态的融合，而小米汽车将全面重新定义汽车工业的技术栈，这将是汽车工业技术范畴的一次重大跨越。这次技术发布会将是小米创办13年来，技术积累的集大成展示，时间会比较长。

4) 福田汽车：预计今年商用车市场规模约为400万辆，明年达420万辆-430万辆

福田汽车在接受机构调研时表示，商用车市场1-11月份已达到367万辆，公司预计今年整体销量在400万辆左右，明年预计市场总量会在420万到430万辆之间。其中，2023年1-11月份轻卡销售约171万辆，同比增长15.3%，随着消费复苏，同时受到新蓝牌法规及新能源政策影响，市场向合规化、新能源化发展趋势明显，2023年市场容量预计达到185万辆，同比增长15%。

福田汽车11月销售6.3万辆，同比增长125.26%，市占率17.26%，同比增长6.18个百分点；1-11月销售56.6万辆，同比增长33.50%，市占率15.45%，同比增长1.05个百分点，整体趋势向好。福田汽车表示，公司有信心冲击今年63万挑战目标。目前福田汽车轻卡毛利率在9.8%左右，比去年增长0.8个百分点。

5) 长安汽车与赣锋锂业达成合作，加快推进（半）固态电池项目研发

12月25日，长安汽车发布公告称，2023年12月22日，公司与江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“赣锋锂业”）在浙江宁波签署了《合作备忘录》。

长安汽车及其关联方与赣锋锂业有意建立长期战略合作关系，将按照“对等持股、高效运营”的原则，加快推进（半）固态电池研发合资项目及制造产业化项目，并基于下一代汽车动力电池（半）固态电池研发合作，探讨向电池上游锂矿资源、锂盐深加工、电池材料，中游电池制造及下游废旧电池综合回收利用延伸合作，推进电池产业全链条战略合作。

6) 传特斯拉将采台积电N3P制程生产下一代FSD芯片

供应链消息传出，预计特斯拉将采用台积电2024年下半年量产的N3P制程生产后续新一代的全自动辅助驾驶芯片（FSD芯片）。根据台积电此前披露的制程蓝图，N3P制程是先进版3纳米系列之一，2024年投产，与N3E相比性能提升5%，功耗降低5%~10%，芯片密度提高1.04倍。此前台积电总裁魏哲家在法说会上透露，N3P经内部评估，整体功耗表现足以与竞争对手18A（2nm以下制程）匹敌，甚至享有更好的技术成熟度与成本优势。

资料显示，FSD架构是在数据、算法、算力等各个层面打造了一套包含感知、规控、执行在内的全链路自动驾驶软硬件架构。特斯拉旧款FSD芯片采三星14纳米生

产，后续升级至三星 7 纳米制程，而后考虑设计升级、量产品质及生产规模，其 HW 4.0 自动驾驶芯片订单转向台积电 5 纳米制程生产。

7) 蔚来汽车：ET9 已申请专利达到 525 项

蔚来在 NIO Day 2023 上，蔚来智能电动行政旗舰 ET9 正式亮相，车长 5,325 毫米、宽 2,016 毫米、高 1,620 毫米、轴距 3,250 毫米，采用飞航车身设计。ET9 是蔚来全栈技术布局 and 全球领先科技的结晶之作，汇集了 17 项全球首发技术、52 项同级领先技术，已申请专利达到 525 项。

NIO Day 2023 上，蔚来也发布了第四代换电站与 640kW 全液冷超快充桩。第四代换电站支持多品牌共享换电，换电时间缩短 22%；配备站顶光伏系统，每座站每年节约近 1.8 万度电。蔚来 640kW 全液冷超快充桩，最大电流 765A、最大电压 1,000V、峰值充电功率 640kW，可智能实时分配站内充电功率。2024 年，蔚来目标新增 1,000 座换电站，新增 20,000 根充电桩，进一步提升用户体验。

2.4 AI 板块

1) OpenAI 传就新一轮融资展开讨论 估值或逾 1000 亿美元

引述知情人士说法称，OpenAI 正在洽谈进行新一轮融资，估值或达至少 1000 亿美元。不过，有关新一轮融资的洽商仍在初步阶段，且融资的条款、估值和时间未有定论，仍有变动可能。

CBInsights 数据显示，若按计划推动本轮融资，OpenAI 将成为美国市值第二高的新创公司，仅次于马斯克 (Elon Musk) 的太空科技公司 SpaceX。

2) 联发科 AI 芯片 蔡力行唱旺

手机品牌大厂 vivo 首发搭上联发科 AI 芯片天玑 9300，开卖首日就达前一代销量的 7.4 倍，出师告捷，联发科执行长蔡力行昨 (23) 日指出，销售状况确实超乎联发科跟 vivo 预期，但天玑 9300 成功不会是一个段落，还有 9400、9500 和 9600 会一个接着一个，“而且一定是愈做愈好”，预告明年销售动能将持续。

蔡力行在演讲时提到，未来十年半导体产业还是可以保持将近一成的年均复合成长率。业界也普遍预期，生成式 AI 将会为人类生活带来巨大变化，也将成为半导体产业未来最大增长动能之一。蔡力行指出，生成式 AI 影响力巨大，就像 1990 年代网路浪潮一样，生成式 AI 需要巨大无比的算力、记忆体，这些都与半导体产业相关。

3) AIPC 将成推动 DRAM 和 NAND 市场复苏关键

随着搭载人工智能 (AI) 功能的新型 AIPC 的陆续发布，业界认为这一趋势不仅将拉动市场对高性能 DRAM 的需求，还将带动尚未从低迷中复苏的 NAND 闪存的市场需求。

随着新的 AIPC 产品采用的 CPU 全面支持 DRAM LPDDR5 和 LPDDR5X, DRAM 的需求预计将增加。这种需求激增预计将扩展到用于存储人工智能学习数据的固态硬盘 (SSD) 以及通用闪存 (UFS) 等产品。包括三星电子、LG 电子和惠普等 PC 厂商最近都推出了搭载英特尔和 AMD CPU 的 AIPC 产品。AIPC 直接在个人电脑上利用生成式 AI，即使没有互联网连接，也无需云连接即可进行快速处理。

4) 你相信光吗? AI 热潮激发硅光技术“芯”应用

生成式 AI、大模型成为新一轮科技产业发展的智能底座,由此引发的庞大算力需求极大带动了硅光芯片等相关技术的进一步发展。据报道,此前台积电组建了一支大约 200 人的研发团队,积极推进硅光子技术,并与博通和英伟达等大客户谈判,共同开发相关技术应用;另一芯片巨头英特尔也致力于发展硅光芯片技术。SEMI 预测,2030 年全球硅光子学半导体市场规模将达 78.6 亿美元。受生成式 AI 等市场的驱动,硅光芯片正展现出广阔的发展前景。

2.5 面板板块

1) 机构:全球显示设施投资 2024 年将增加 82%至 85 亿美元

市场研究公司 DSCC 近日预测,2023 年全球显示设施投资将减少 61%至 47 亿美元,明年将增加 82%至 85 亿美元,2025 年将增加 25%至 106 亿美元。其中,有机发光二极管(OLED)在显示设施投资中的比例预计 2024 年将达到 54%,2025 年将达到 84%。

DSCC 预计,明年 OLED 设施投资规模预计与 2021 年相似,2025 年 OLED 设施投资规模预计与 2020 年相似。报告称,尽管 OLED 在设备投资中的比例不断增加,但 LCD 在全球显示器产能中的比例预计将继续保持压倒性的份额。OLED 在显示器总产能中的占比预计仅小幅增长,从 2022 年的 8.4%增至 2027 年的 10.6%。

2) 12 月下旬电视面板价格下跌,法人评价友达、群创

12 月下旬 TV(电视)面板报价续跌,分析师表示,原因在于年底旺季促销相关需求已降温,且显示器面板报价亦随之走跌,至于笔记本电脑面板报价则与 12 月上旬持平,主要系多数客户仅释出零星订单所致。就评价而言,预估明年第 1 季以前,TV 面板报价易跌难涨,不利于面板供应链改善业绩,维持对友达、群创中立的投资建议。

法人机构指出,由于电视品牌、供应链从业者因应年底旺季促销而建立 TV 面板库存的动作已陆续告一段落,12 月下旬 TV 面板报价续跌,55 吋 4K Open-cell 报价下跌 1 美元,跌幅为 0.8%,12 月跌幅 1.6%,报价自 11 月上旬下跌迄今、幅度为 3.1%。

3) 处理器三星将双轨开发 OLEDoS 和 LEDoS

三星将双轨开发硅基有机发光二极管(OLEDoS)和硅基 LED(LEDoS),三星集团内部高管已采取措施将这两种新型微显示技术的开发轨道分开,实施组织机构、人员调整和相关职责划分。

据悉,LEDoS 开发将由三星电子设备解决方案(DS)部门负责,OLEDoS 开发将由三星显示(SDC)负责,这与之前的行业传言一致。

三星 DS 部门内的化合物半导体解决方案(CSS)业务部门将负责 LEDoS 开发项目。然而,面临的重大技术挑战是,如果技术缩小到 20 微米或 10 微米以下,性能可能会显著下降。CSS 业务部门是通过最近的组织重组而成立的,涵盖致力于 LED 开发、功率元件和其他设备的各个实体。

三、 公司动态跟踪

图表 9：过去一周股东增减持更新

证券代码	证券简称	最新公告日期	变动方向	股东名称	股东身份	拟变动数量上限	拟变动数量上限占总股本比(%)
688699.SH	福晶科技	2023-12-28	减持	陈辉	董事长	593,550.00	0.14
688699.SH	睿能科技	2023-12-26	减持	睿能实业有限公司	5%以上第一大股东	6,000,000.00	2.85
688699.SH	华天科技	2023-12-28	增持	天水华天电子集团股份有限公司	控股股东		
688699.SH	芯源微	2023-12-30	减持	沈阳先进制造技术产业有限公司	股东	1,378,870.00	1.00
688699.SH	本川智能	2023-12-27	减持	黄庆娥	特定股东	1,533,500.00	2.00
688699.SH	恒烁股份	2023-12-30	减持	宁波梅山保税港区天鹰合胜创业投资合伙企业(有限合伙)	股东	1,240,000.00	1.50
300322.SZ	恒烁股份	2023-12-30	减持	北京昆仑互联网智能产业投资基金合伙企业(有限合伙)	股东	595,000.00	0.72
300322.SZ	恒烁股份	2023-12-30	减持	深圳前海蓝点电子信息产业股权投资合伙企业(有限合伙)	股东	645,000.00	0.78
688047.SH	GQY 视讯	2023-12-27	减持	袁向阳	5%以上股东郭启寅先生的一致行动人	890,959.00	0.21
688368.SH	联建光电	2023-12-29	减持	何吉伦	持股 5%以上股东	10,982,276.00	2.00
301183.SZ	木林森	2023-12-29	减持	济南汇盛投资合伙企业(有限合伙)	持股 5%股东	7,420,800.00	0.50
002885.SZ	光峰科技	2023-12-28	减持	Blackpine Investment Corp. Ltd	股东	798,802.00	0.17
002463.SZ	光峰科技	2023-12-28	减持	深圳市光峰宏业投资有限合伙企业(有限合伙)	股东	2,061,030.00	0.45
688120.SH	光峰科技	2023-12-28	减持	深圳市光峰达业投资有限合伙企业(有限合伙)	股东	3,374,083.00	0.73
688120.SH	光峰科技	2023-12-28	减持	深圳市金镭晶投资有限合伙企业(有限合伙)	股东	2,460,400.00	0.53
835179.BJ	格林达	2023-12-27	减持	宁波聚合股权投资合伙企业(有限合伙)	5%以上非第一大股东	9,977,919.00	5.00
003028.SZ	华海清科	2023-12-27	减持	清津厚德(天津)科技合伙企业(有限合伙)	股东	2,137,967.00	1.35
003028.SZ	华海清科	2023-12-27	减持	清津立德(天津)科技合伙企业(有限合伙)	股东	231,983.00	0.15
003028.SZ	骏亚科技	2023-12-28	减持	骏亚企业有限公司	5%以上第一大股东	19,579,353.00	6.00

数据来源：Wind，华福证券研究所

图表 10：过去一周股权激励一览

代码	名称	公告日期	进度	激励方式	激励总数 (万)	激励总数占当时 总股本比例(%)	期权初始 行权价格
600552.SH	凯盛科技	2023-12-27	董事会预案	授予期权, 行权股票来源为上市公司定向发行股票	1,811.11	1.9173	12.59
002185.SZ	华天科技	2023-12-26	股东大会通过	授予期权, 行权股票来源为上市公司定向发行股票	25,000.00	7.8016	7.26
600237.SH	铜峰电子	2023-12-29	实施	上市公司定向发行股票	1,115.30	1.7940	3.91
688591.SH	泰凌微	2023-12-30	股东大会通过	上市公司定向发行股票	360.00	1.5000	16.17
301369.SZ	联动科技	2023-12-27	实施	上市公司定向发行股票	16.60	0.2385	34.06
301369.SZ	联动科技	2023-12-27	实施	上市公司定向发行股票	305.51	4.3895	34.06
600237.SH	铜峰电子	2023-12-29	实施	上市公司定向发行股票	1,115.30	1.7940	3.91
603068.SH	博通集成	2023-12-28	实施	授予期权, 行权股票来源为上市公司定向发行股票	628.00	4.1748	31.37

数据来源: Wind, 华福证券研究所

四、 风险提示

新车量产及交付时间延期风险, 新能源车销量不及预期, 行业竞争加剧, 地缘政治风险, 电子行业景气复苏不及预期。

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

一般声明

华福证券有限责任公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告的信息均来源于本公司认为可信的公开资料，该等公开资料的准确性及完整性由其发布者负责，本公司及其研究人员对该等信息不作任何保证。本报告中的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，之后可能会随情况的变化而调整。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

在任何情况下，本报告所载的信息或所做出的任何建议、意见及推测并不构成所述证券买卖的出价或询价，也不构成对所述金融产品、产品发行或管理人作出任何形式的保证。在任何情况下，本公司仅承诺以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告以供投资者参考，但不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的承诺或担保。投资者应自行决策，自担投资风险。

本报告版权归“华福证券有限责任公司”所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

特别声明

投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有本报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

投资评级声明

类别	评级	评级说明
公司评级	买入	未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅在 20%以上
	持有	未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅介于 10%与 20%之间
	中性	未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅介于-10%与 10%之间
	回避	未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅介于-20%与-10%之间
	卖出	未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅在-20%以下
行业评级	强于大市	未来 6 个月内，行业整体回报高于市场基准指数 5%以上
	跟随大市	未来 6 个月内，行业整体回报介于市场基准指数-5%与 5%之间
	弱于大市	未来 6 个月内，行业整体回报低于市场基准指数-5%以下

备注：评级标准为报告发布日后的 6~12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现。其中，A 股市场以沪深 300 指数为基准；香港市场以恒生指数为基准；美股市场以标普 500 指数或纳斯达克综合指数为基准（另有说明的除外）。

联系方式

华福证券研究所 上海

公司地址：上海市浦东新区浦明路 1436 号陆家嘴滨江中心 MT 座 20 层

邮编：200120

邮箱：hfyjs@hfzq.com.cn